

### 特点:

- 良好的幅度不平衡度: 典型值 $\pm 0.3\text{dB}$
- 低插入损耗: 典型值  $2.0\text{dB}$
- CQFN20 封装  $4.0 \times 4.0 \times 1.5\text{ mm}^3$
- 工作温度:  $-55 \sim +85^\circ\text{C}$
- 执行标准为 GJB8481-2015

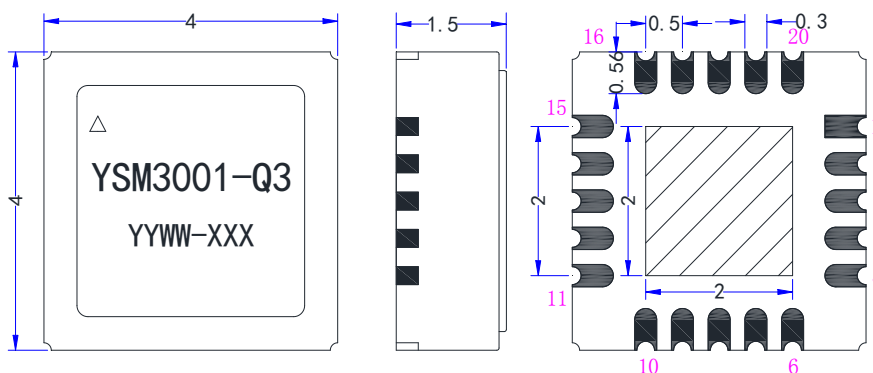
### 性能参数: ( $T_A=25^\circ\text{C}$ , $50\Omega$ 系统)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$	2		8	GHz	全温
插入损耗	IL	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$ $f=2\sim 8\text{GHz}$ $P_{in}=0\text{dBm}$		2.0	2.8	dB	全温
幅度不平衡度	AU			$\pm 0.3$	$\pm 0.7$	dB	
输入驻波比	VSWR <sub>i</sub>			1.5:1	2.5:1		全温
输出驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.5:1	2.0:1		全温
隔离度	ISO			13.0	15.0		dB
质量	m					1	g

### 极限参数表:

参数名称	极限值	单位
贮存温度	$-55 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
输入射频功率	0.5	W

### 封装外形图:

 单位: mm 公差:  $\pm 0.2\text{mm}$ 


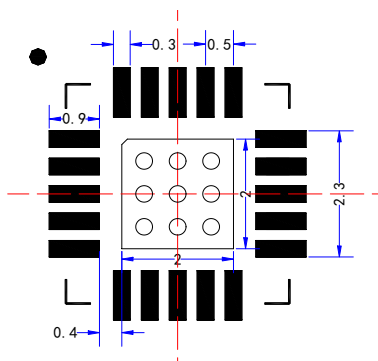
### 字符标志:

YSM3001-Q3	产品型号
$\Delta$	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

### 引脚定义:

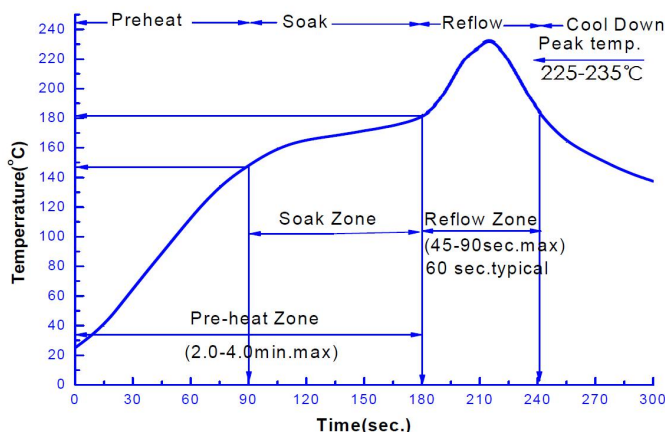
引脚	定义	描述
3	RFC	射频公共端口
8	RF1	射频输出端口 1
18	RF2	射频输出端口 2
1/5/6/10/11/13/15/16/20/底部中央焊盘	GND	接地
其他	NC	悬空

### 推荐焊盘图:

 单位: mm 公差:  $\pm 0.1\text{mm}$ 


### 产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件, 耐静电能力 $\leq 250\text{V}$ , 产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护;
2. 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域);
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点  $183^\circ\text{C}$  回流焊接, 回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线, 因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过  $230^\circ\text{C}$ 。

4. 如特殊情况需采用手工焊接, 烙铁温度  $350^\circ\text{C}$ , 焊接时间不超过 3 秒; 回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装, 存放条件: 温度  $10\sim 35^\circ\text{C}$ , 湿度  $35\sim 65\%\text{RH}$ ; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对宇熙产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。